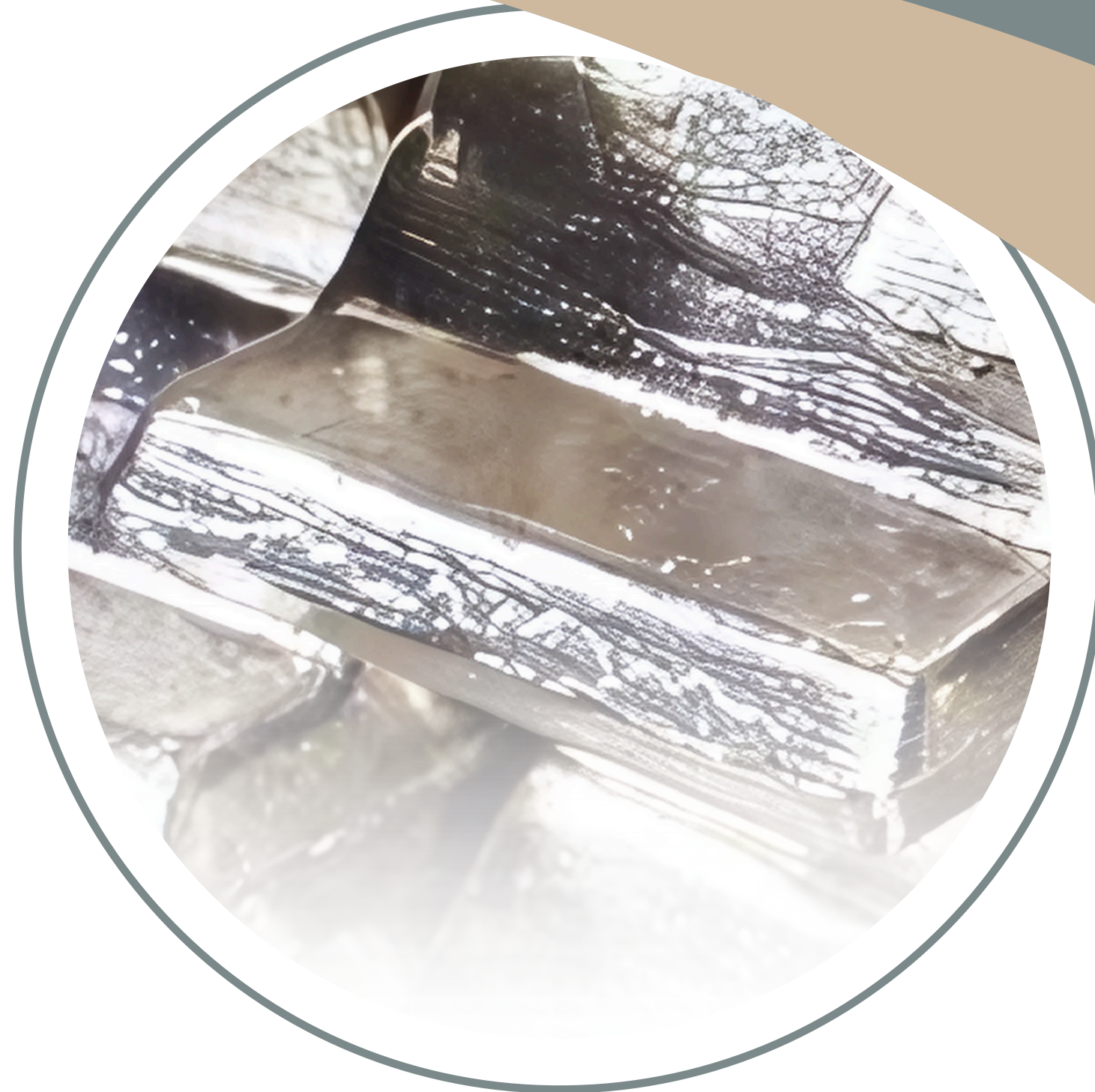




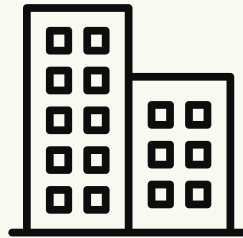
瑞昇金屬工業股份有限公司
REDSUN METAL IND. CO., LTD.

先進焊接技術： 關於瑞昇和核心產品系列



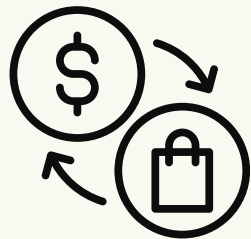
瑞昇金屬工業股份有限公司

1974年7月創立 | 金屬溶劑製造商



來自台灣，專注於電子級焊錫材料與溶劑製造。
憑藉數十年的經驗與日本技術合作，我們已成為在地領先的焊錫與金屬材料製造商。

我們通過**IATF 16949**、**ISO 9001**與**ISO 14001**等認證，持續創新並拓展產品多樣性，提供高品質且符合環保理念的解決方案，服務全球市場。



業務遍及歐洲、美國、日本、中國、泰國、馬來西亞、越南、印尼等地，並積極開拓新興市場，推動永續成長。



關於瑞昇

50+

年深耕市場

\$250M

資本額
(NTD)

40%

金屬錫市佔率

45%

銅球市佔率

8+

全球據點

天津

南通

昆山

上海

東莞

八德

台北

中壢

瑞昇引領市場的核心系列

創新，始於每一個焊接點



錫絲 (有鉛/無鉛)

高純度焊錫線，適用於一般電子與波峰焊接。符合RoHS與REACH規範。

優異的
潤濕性

極佳導電性

穩定可靠



助焊劑 (含鍍錫助劑)

符合IEC 61249-2-21標準，質量無憂。
適用於鍍錫、預焊表面處理、高速自動線
潤濕增強

無鹵配方

強化鍍層
均勻性

強效去氧化



錫膏 (有鉛/無鉛)

通過JIS-Z-3282認證。
適用於SMT製程、精密間距元件與高可靠性焊接，廣泛應用於電子、汽車與電信領域。

優異的
印刷性

強力接著
性能

降低
瑕疵率



各類金屬粉末 (錫粉)

適用於錫膏製造、微電子封裝、3D焊錫列
印與選擇性焊接工藝

顆粒大小
均勻

高純度

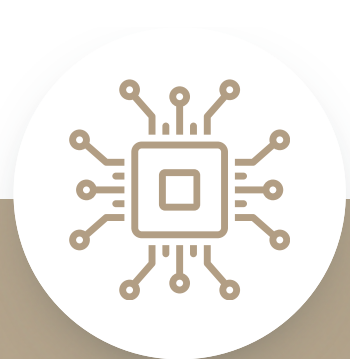
適用於
高精密應用

深受業界領導品牌信賴

獲得全球產業領導者的高度信任



電子製造與消費性科技



半導體與IC封裝



電子化學與先進材料





錫絲

(有鉛/無鉛)

多樣合金選擇以滿足不同需求 (包含Sn60/Sn63)
提供含鉛與無鉛方案
精準焊接 | 極少飛濺

錫絲

順暢流動 | 飛濺最小化

- 多種合金含鉛與無鉛供選擇
- 適用於手動與自動焊接
- 多種線徑 | 全方位應用
- 品質穩定 | 接點可靠

推薦應用領域:



消費性電子



車用電子



PCB組裝



工業製造





錫膏

(有鉛/無鉛)

自有產線生產焊粉與助焊劑 | 全程品質掌控
高純度配方 | 含鉛與無鉛可選
優異印刷性

有鉛和無鉛錫膏

錫膏符合JIS-Z-3282及RoHS的規範

- 無論含鉛或無鉛皆有優異焊接表現與殘留控制
- 多種合金組成可選，適用高可靠性應用
- 穩定黏度，確保一致性
- 可應用於低中高溫製程
 - 下錫性的可靠

推薦應用領域:



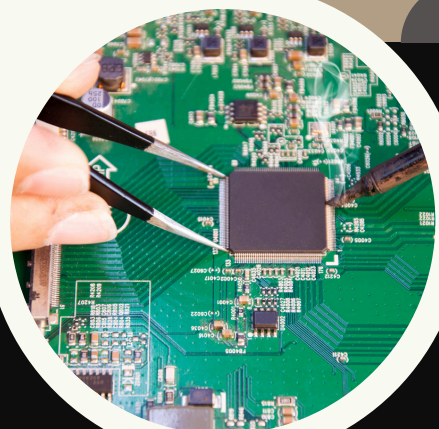
消費性電子



車用電子



SMT應用



精密間距元件



LED與顯示器製造





助焊劑

符合IEC 61249-2-21標準，質量無憂
絕緣電阻測試合格 | 可選無鹵配方
適用於SMT、IC封裝與波峰焊接
高活性 | 低殘留

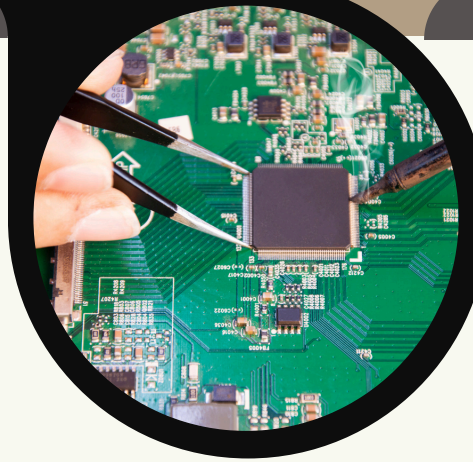
液體助焊劑



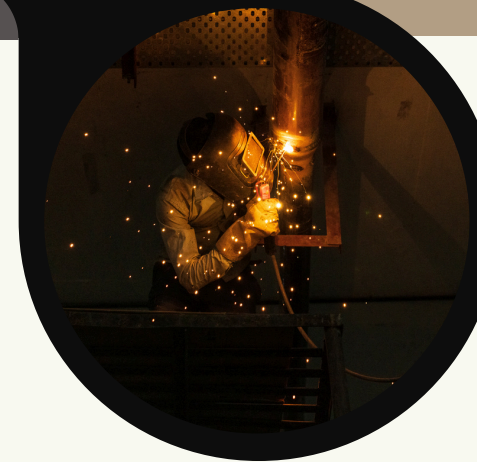
車用電子



SMT與DIP製程



電子裝配與維修



工業製造



無鹵配方, 綠色製造首選

確保符合環保與安全規範, 強化作業安全並促進環境友善製程



優異潤濕性

顯著提升焊接展布效果, 減少缺陷, 提升接點完整性



低殘留

降低清洗需求, 節省人力與生產成本



穩定可靠

品質一致, 適用於自動與手動焊接

鍍錫專用助焊劑



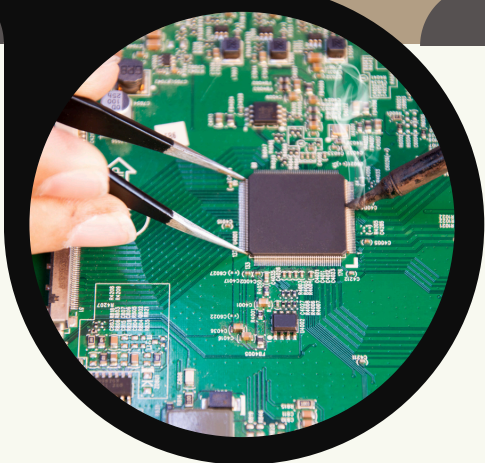
電線電纜



車用電子



SMT與DIP製程



電子裝配與維修



工業製造



透明無鹵配方

0%鹵素，減少設備腐蝕，延長壽命並確保清潔操作



合規認證

符合IEC 61249-2-21標準，質量無憂



高效鍍錫

強化鍍層均勻性，有效提升產線效率與線材／端子品質



多種包裝規格可選

提供20公斤與200公斤兩種包裝，滿足不同生產需求



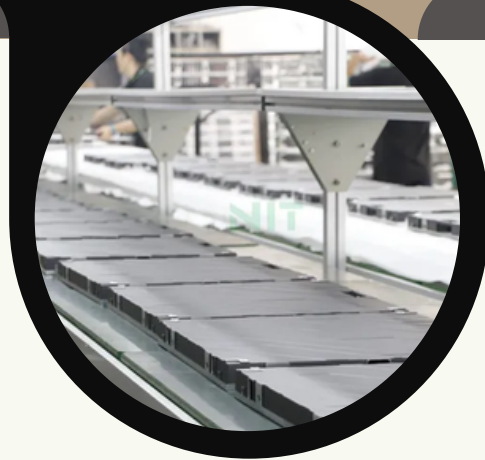
各類金屬粉末

(錫粉)

先進焊接應用設計 | 內製生產 | 極致純度與一致性
專為電子與半導體製造最佳化

各類金屬粉末 (錫粉)

卓越純度與穩定性



LED與顯示器製造



車用電子



半導體封裝



醫療設備



工業自動化



高純度

確保一致熔點與優異導電性



顆粒球形均勻

提升流動與印刷穩定性



可客製合金與粒徑

因應不同製程需求,提供不同合金合粒
徑選擇



自有產線生產

品質控管嚴格, 迅速滿足客戶需求

各類金屬粉末（規格）

合金種類與應用:

合金類型	熔點	特性	應用領域
錫-鉍 (Sn-Bi, Sn42Bi58)	約138°C	低溫、無鉛、環保	無鉛電子、醫療裝置、精密裝配
鉛-錫 (Pb-Sn)	183–300°C	優異導電性、易熔化	傳統電子、管道密封、玻璃-金屬封裝
錫-銀-銅 (SAC)	約217–245°C	無鉛、高導電性、穩定焊接	無鉛電子、醫療裝置、精密裝配
客製合金 (Bi, Sn, Pb, In, Ag)	47–200°C	可調配方	模具製作、3D列印支撐、熱控閥件

粒徑規格:

類型	粒徑範圍	淨重
TYPE3	45–25 μm	可依需求客製
TYPE4	38–20 μm	
TYPE5	25–15 μm	
TYPE6	15–5 μm	
TYPE7	11–2 μm	



瑞昇代理產品

除自有品牌製程材料外，瑞昇亦長期代理多項國際原料供應商之產品，以支援客戶多元製程需求。



銅球, 銅塊 | 三菱材料

瑞昇代理三菱材料之高純度銅球與銅塊，廣泛應用於半導體封裝與高階電子製程中，具備穩定導電性與優異加工性。



黑膠, 白蠟, 潤模條 | 長春化工

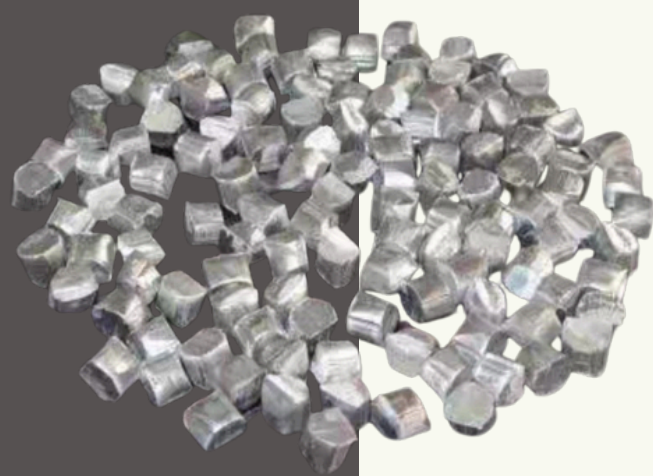
瑞昇長期配合長春化工，提供高品質黑膠、白蠟與潤模條，適用於IC封裝、模具釋放與電子材料製程，兼具黏著性、耐熱性與穩定性。

瑞昇精選特殊原料

精選特殊原料，全面支援您的製程需求。



鋁錠



瑞昇提供工業級鋁錠，適用於合金鑄造、電子散熱基板與結構材料生產，具備良好導熱性與加工穩定性。



銦錠



瑞昇供應高純度銦錠，廣泛應用於低熔點合金、半導體、ITO導電膜與電子焊接材料，具備優異的延展性與導電性。

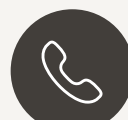


瑞昇金屬工業股份有限公司
REDSUN METAL IND. CO., LTD.

聯絡我們!



info@redsuncom.com.tw



+886-2-87978992



www.redsuncom.com.tw



No. 133, Xinhu 1st Rd.,
Taipei City, Taipei, 114065
Taiwan

